

LOW PRESSURE HOTMELT MOLDING

ホットメルトモールディング

TECHNOMELT® (テクノメルト) ホットメルトモールディングは低温、低圧で成形ができるため、繊細な電子部品へダメージを与えません。また、3つのプロセスでモールドが部品を確実に保護し、製品の生産性と信頼性向上に貢献します。

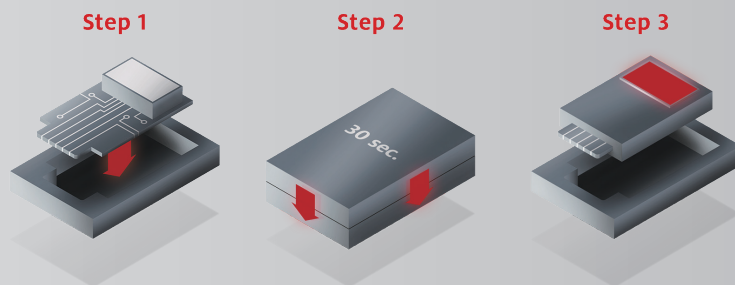
■ 特長

- ポッティングの場合は必要となる筐体・ケースなどを置き換えることで生産を効率化
- サイクルタイムの短縮 (15 ~ 50 秒で完成)
- 軽量化、モールド材料削減
- 無溶剤 1 液型
- 防水性向上
- 外的負担や環境影響を低減
- 繊細な部品の保護
- 難燃性 (UL94 V-0)、高耐熱性タイプあり

■ プロセス

わずか3つのプロセスで電子製品を封止できます。

1. 封止したい電子部品を金型にセットします。
2. TECHNOMELT® (テクノメルト) の樹脂が低圧・低温で電子部品を封止します。
3. 金型から取り出した直後に部品をテストし、最終組み立てへと移行します。



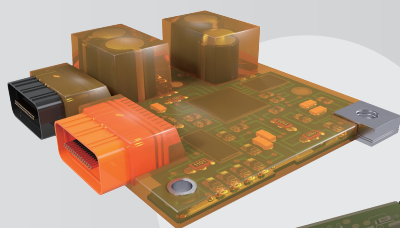
■ ホットメルトモールディング用製品ラインナップ

製品名	TECHNOMELT PA 673N	TECHNOMELT PA 678 BLACK	TECHNOMELT PA 652N	TECHNOMELT PA 657 BLACK	TECHNOMELT PA 641	TECHNOMELT PA 646 BLACK	TECHNOMELT PUR 3460
種類	ポリアミド						反応型ウレタン
外観	黄褐色	黒色	黄褐色	黒色	黄褐色	黒色	淡黄色
使用温度範囲 (°C)	-40 ~ 140		-40 ~ 100		-40 ~ 130		-40 ~ 100
軟化点 (°C)	185		155		175		—
粘度 (mPa・s)	3,400 / 210°C		4,100 / 210°C		7,000 / 210°C		10,000 / 130°C
硬度 (shore)	A90		A77		A92		D42 (硬化後)
UL94	V-2	V-0	V-0	V-0	—	V-0	—
体積抵抗率 (Ω・cm)	1.9×10^{12}	1.9×10^{12}	1.0×10^{12}	7.2×10^{11}	3.2×10^{12}	1.7×10^{12}	4.6×10^{13}
絶縁破壊電圧 (kV/mm)	20	> 20	> 14	15	25	22	—
製品特長	耐熱性		柔軟性		強靱性		強靱性・接着性

■ 採用事例

PCB オーバーモールディング

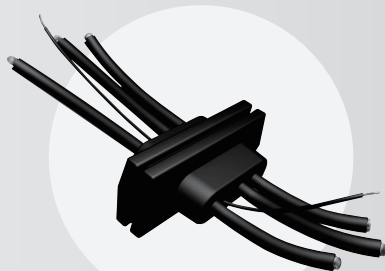
詳しくはこちら▼



コネクタ／センサー



グロメット



ヘンケルジャパン株式会社

〒235-0017 横浜市磯子区新磯子町27-7
TEL : 045 (758) 1800 www.henkel-adhesives.com/jp/ja

接着に関する技術的なお問い合わせは

045-758-1842 JP.AE-CSdesk@henkel.com

記載されている商品の仕様およびデザインは、2022年3月現在のものです。改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。

※無断転載・転用を禁止します。(写真・文章)

本製品をご使用になる前に下記事項をご承諾下さい。

1. 本製品のご使用にあたっては、用途・目的に適合するかどうかを必ずご使用になられる方ご自身で検討いただき、最終判断をして下さい。
2. 本製品の取り扱いに関しては、ご使用になる前にご使用になられる方ご自身が十分に検討し、安全にご使用下さい。
3. 本書に記載されている事項は現時点での最終情報であり、予告無く改定することがあります。
4. 弊社の管理の及ばない製造物、施工物の不具合に関する損害補償は致し兼ねます。



L283-2203A (AI)